I-Ⅲ-Ⅵ₂族化合物半導体 CuInS₂の異方性を持つ物性値の解析

永岡 章¹⁾·吉野 賢二²⁾·碇 哲雄³⁾

Analysis of Anisotropic Properties of I -III-VI₂ Compound Semiconductor CuInS₂

Akira NAGAOKA, Kenji YOSHINO, and Tetsuo IKARI

Abstract

 $CuInS_2$ single crystals were grown by a traveling heater method, which is one of the solution growth techniques. Temperature dependent X-ray diffraction of the $CuInS_2$ was carried out between 10 and 300 K. A lattice constant of a-axis decreased and that of c-axis increased with increasing temperature. A linear thermal expansion of a-axis calculated from the lattice constants showed negative value. It was assumed that decreasing the linear thermal expansion indicated one of the factors of increasing bandgap at low temperature.

Keywords: Chalcopyrite semiconductors, Traveling heater method, Linear thermal expansion, XRD

はじめに

I-Ⅲ-VI,族カルコパイライト型半導体は、直接遷移型 のバンド構造を有し、バンドギャップが元素の組み合わせ を変えることで赤外から紫外領域までわたり、禁制帯幅付 近で大きな光吸収係数を持つことから、太陽電池等の光デ バイスとして期待されている。現在 Cu(In, Ga)Se₂ (CIGS) を用いた薄膜多結晶太陽電池は実用化されており最高変 換効率 19.9%も達成されてい¹⁾。また、AgInSe₂や AgGaSe₂ は赤外域において高い透過率を持ち、非線形光学係数が高 いため CO₂ レーザーに利用されている ^{2,3)}。一方で、 I ー Ⅲ-VI₂族カルコパイライト化合物は多元系であるが故に 元素半導体であるSiやGeには無い特徴的な物性値を持っ ており、1970年代から本格的な研究が行われているが、 現在も詳細な解明がされていない。例として、I-II-VI2 族半導体に属する AgGaSe2 は、低温側において線膨張係 数が減少し、さらにバンドギャップも増大する 4)。通常、 半導体において Varshni の式で表されるように温度増加と ともにバンドギャップは減少する 5。Ⅱ-VI族、Ⅲ-V族二 元系半導体では、温度変化によるピークエネルギーの増加 や線膨張の減少は観察されない。 I -Ⅲ-Ⅵ2族カルコパ イライト化合物は、二元系化合物とは異なり、2種類のカ チオンと 1 種類のアニオンによってイオン結合だけでな く、共有結合の影響も受けることで、相互作用の影響も大

- 1) 電気電子工学専攻大学院生
- 2) 電気電子工学科准教授
- 3) 電気電子工学科教授

きくなってくる。そのため、特異な物性の解明が困難となる。本研究で注目した CuInS_2 は、フォトルミネッセンス $\operatorname{(PL)}$ 測定 6 、フォトリフレクタンス $\operatorname{(PR)}$ 測定 7 の低温側においてバンド端に関するピークエネルギーが増大するという報告がある。低温における線膨張の異方性がピークエネルギーの増大に影響していると考え、 CuInS_2 の線膨張係数の温度変化からピークエネルギー増加の解明を行った。

基礎物性値の評価を行う上で格子欠陥の少ない良質な単結晶を用いて行うことが理想である。しかし、カルコパイライト型化合物は、融点以上において相転移によってカルコパイライト構造となる CuInSe2⁸⁾や CuGaSe2⁹⁾のように冷却中に組成のずれた固相と液相が反応することでカルコパイライト構造になる包晶反応を示す。このように融液成長から単相で良質な大型単結晶を成長させることは困難である。良質な単結晶成長が困難であることも、物性が解明されない原因となっていると考える。そこで、本研究において単結晶成長法に溶液成長の一つである移動ヒーター法(THM)を用いて単結晶成長を行った。

2. 実験方法

THM 成長の種原料のために、まず $CuInS_2$ の多結晶インゴットを作製した. $CuInS_2$ の化学量論組成と一致するように Cu、In、S の元素の規定量を石英アンプルに封入した。元素を詰めたアンプルは、高真空下で封入し、アンプルは

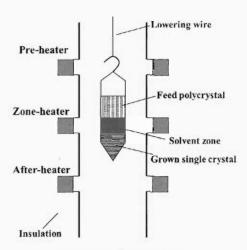


Fig. 1 THM 法の原理図.

垂直電気炉に入れ、1100℃まで上げ、24 時間保温した。 多結晶インゴットは、直径 9 mmで 40 mm程度の長さである。 $CuInS_2$ の多結晶インゴットと溶媒の In を高真空下で石英アンプルに封入した。成長温度は 800℃、温度勾配は約 40 ℃/cm とした。4-5 mm/day のスピードでアンプルを吊るして結晶成長を行った。Fig. 1 に THM 成長原理図を示す。

結晶の評価として X 線回折(XRD)、バンド端に関係するピークエネルギーを求めるために PL 測定を行った。

XRD 測定では、測定温度を 10~300 K、加速電圧 40 kV、管電流 100 mA で、Cu ターゲットに衝突させて得られる Kα線(λ =1.54050 Å)を用いた。CuInS₂ は正方晶系であるので,面間隔 d、面指数 (h k l)、格子定数 a、c は式(1)を満たす 10 。

$$\frac{1}{d} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2} \tag{1}$$

各軸の線膨張係数は式(2)を用いて算出した。

$$\alpha_{a,c} = \frac{1}{l_{a}} \frac{dl}{dT}$$
 (2)

ここでは α_a 、 α_c は各軸の線膨張係数、 I_0 は 300 K 時の a、c 軸の格子、dl/dT は格子定数の温度変化分である。

PL 測定では、測定温度を 8~300 K に設定し測定を行った。励起光源として Ar レーザー (514.5nm) を用いた。試料から出たルミネッセンスは、集光レンズによりシングルモノクロメーター (f=50 cm 日本分光 SS50) の入射スリットに結像され、光電子増倍管 (Hamamatsu R928)によって検出し、検出した光はデジタルマルチメーターによって変換され出力した。

3. 実験結果および考察

3.1 THM 成長

成長温度 800 $^{\circ}$ C、溶媒として In を用いることで CuInS₂ 単結晶が得られた。得られた CuInS₂ 単結晶の粉末 XRD 測定を室温で行った。 Fig. 2 に CuInS₂ の室温粉末 XRD スペクトルを示す。得られたスペクトルは、ICDD データの主要なピークである(112)ピーク=27.88 $^{\circ}$ 、(204)ピーク=46.30 $^{\circ}$ 、

(312)ピーク=54.99°と一致した。スペクトルから Cu-S 系、In-S 系の化合物の異相は観察されなかった。

3.2 格子定数温度変化

Fig. 3に $10\sim300$ KにおけるCuInS $_2$ 単結晶粉末のXRDスペクトルを示す。a軸、c軸の格子定数はそれぞれ、(204)、(312)面の高角側のXRDピークから算出された。Fig. 4に格子定数の温度変化を示す。温度増加とともにa軸は、減少し、c軸は増加と対照的に変化した。ここで歪み率 $\eta=c/2a$ に注目する。カルコパイライト構造の歪み率は、I-VI結合とIII-VIが違うため $\eta<1$ を示す。本研究において、温度増加に伴うa軸の減少によって、温度増加に従って $\eta>1$ は増加していった。つまり、歪み率の観点からも結晶全体としてa軸方向に縮んでいることを示している。

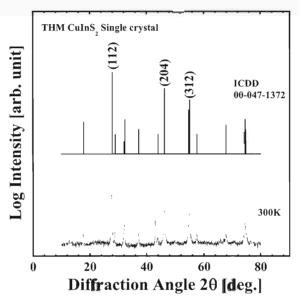


Fig. 2 室温XRDスペクトル.

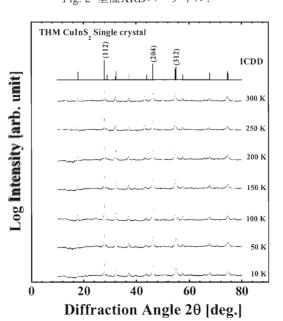


Fig. 3 XRD温度変化.

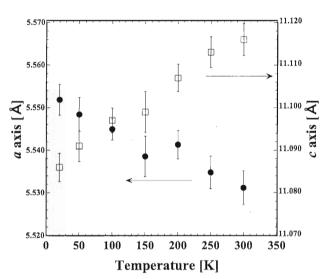


Fig. 4 格子定数温度変化.

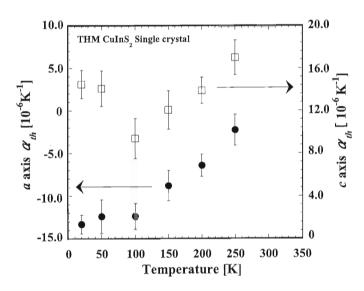


Fig. 5 各軸の線膨張係数温度変化.

3.3 線膨張係数温度変化

各軸の線膨張係数 $\alpha_{a,c}$ の温度変化をFig. 5に示す。 α_a は、全ての測定域において負の線膨張を示し、線形的に変化した。しかしながら、 α_c は100Kにおいて最小値をとり温度増加とともに増加した。

バンドギャップ E_g の温度変化量 $\Delta E_g(T)$ は熱膨張に影響を受けており、式(3)のような関係にある 11 。

$$E_g = E_g(0) + \Delta E_g(T) = E_g(0) + \Delta E_{ph}(T) + \Delta E_{th}(T)$$
 (3)

ここで、 $\Delta E_{ph}(T)$ は電子一格子相互作用項、 $\Delta E_{th}(T)$ は線膨張の項である。このように線膨張は、バンドギャップの変化に作用することから線膨張係数から $CuInS_2$ の低温における特異なピークエネルギー変化へアプローチを行っている。カルコパイライト構造は、 $a=b\neq c$ の格子定数を持っているため、a軸の影響がc軸の2倍であると考える。したがって、負の線膨張はa軸からの影響が大きい。類似し

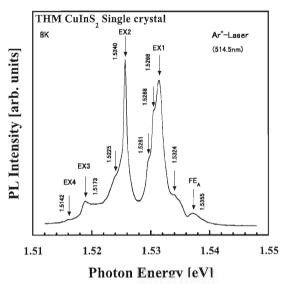


Fig. 6 8KにおけるPLスペクトル.

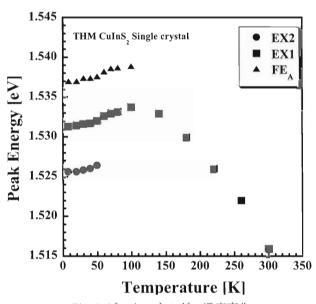


Fig. 7 ピークエネルギー温度変化.

た報告として、 $I-III-VI_2$ カルコパイライト化合物のひとつである $AgGaSe_2$ 結晶はTOK以下において負の線膨張を示す 12 。この場合、c軸が負の線膨張を示すことが影響している。興味深いことに、Cu系カルコパイライト化合物は、Ag系のc軸の負の線膨張と反対にa軸の負の線膨張を持つ。Cu-VIとAg-VIの結合の違いが負の線膨張範囲に影響していると考えられる。

3.4 PL 測定

CuInS₂のPL温度測定を8~300 Kにおいて行った。Fig. 6 に8KにおけるPLスペクトルを示す。8 Kにおいて、1.5355 eVに自由励起子発光(FE_A)、1.5298 eV、1.5240 eV、1.5173 eV、1.5142 eVに束縛励起子(それぞれEX1~4とする)による発光が確認された。自由励起子発光が確認されたことより作製した試料の結晶性が良いことを裏付けした。ピークエネルギーの温度変化をFig. 7に示す。ピークエネルギーは、

温度増加とともに増加していき100 Kにおいて最大値を示した。

低温における特異なピークエネルギーの増加は、負の線膨張を持つことで格子間の距離が縮まり、電子の重なりが増える。結果としてバンドの幅が小さくなり、バンドギャップが大きくなるためピークエネルギーは増大すると考える。更に過去のカルコパイライト化合物の研究報告では、カチオンのd軌道とアニオンのp軌道の混成軌道が本研究のような異常なピークエネルギーの温度依存性に影響していると報告がある $^{13-15}$ 。

4. 結論

 $CuInS_2$ 結晶の低温においてのバンド端に関するピークエネルギーの特異な振る舞いに注目し、 $CuInS_2$ 単結晶の線膨張係数からアプローチを行った。基礎物性の解析を行うためには、格子欠陥の少ない良質な単結晶を用いることが理想である。そこで、 $I-III-VI_2$ 族カルコパイライト化合物単結晶成長に有効なTHM成長を用いて $CuInS_2$ 単結晶作製を行った。

Feedとなる多結晶と溶媒としてInを用いて、成長温度 800°C、成長速度4~5mm/dayで $CuInS_2$ 単結晶が得られた。 XRD測定から異相は見られず、またICDDデータと一致を示した。更にPL測定から自由励起子発光が1.5355 eVで確認されたことより単相で良質な $CuInS_2$ 単結晶であると判断した。

XRD温度変化測定より格子定数を算出した。温度増加とともにa軸の格子定数は減少、c軸の格子定数は増加と対照的な変化をした。カルコパイライト構造の歪み率は、I-VI結合とIII-VIが違うため η <1を示す。本研究において、温度増加に伴うa軸の減少によって、温度増加に従って η >1は増加していった。つまり、歪み率の観点からも結晶全体としてa軸方向に縮んでいることを示している。

格子定数の温度変化から算出したa軸の線膨張係数は、 負の値を示した。PL測定から得られたピークエネルギー は、T<100 Kにおいて温度増加とともに増大した。負の線 膨張により格子間の距離が縮まり、電子の重なりが増える。 結果としてバンドの幅が小さくなり、バンドギャップが大 きくなるためピークエネルギーは増大すると考えた。

参考文献

- I. Repins, M. Contreras, B. Egaas, C. DeHart, J. Scharf, C. Perkins and R. Noufi, Prog. Photovol. Res. Appl. 16 (2008) 235
- P. G. Schunemann, S. D. Setzler and T. M. Pollak, J. Crystal Growth 211 (2000) 257.
- 3) G. W. Iseler, J. Cryst. Growth 41 (1977) 146.
- S. Ozaki, M. Sasaki and S. Adachi: Phys. Status Solidi (a) 203 (2006) 2648.
- 5) Y. P. Varshni, Physica 34 (1967) 149.
- M. V. Yakushev, A. V. Mudryi, Y. Feofanov, A. V. Ivaniukovich and I. V. Victorov, Thin Solid Films 511-512 (2006) 130.
- S. Shirakata and H. Miyake, J. Phys. Chem. Solids 64 (2003) 2021.
- 8) H. Matsushita and T. Takizawa, J. Crystal Growth 179 (1997) 503.
- 9) J. C. Jr. Mikkelsen, J. Electron. Mater, 10 (1981) 541.
- 10) 山口高光: 粉末 X 線による材料分析, 講談社サイエンス, 1993.
- T. Mishima, M. Miura, S. Ozaki and S. Adachi, J. Appl. Phys. 91 (2002) 4904.
- 12) I. V. Bodnar and N. S. Orlova, Inorg. Mater. 23 (1987) 975.
- J. L. Shay, B. Tell, H. M. Kasper and L. M. Schiavone, Phys. Rev. B 7 (1973) 4485.
- 14) P. W. Yu, W. J. Anderson and Y. S. Park, Solid State Commun. 13 (1973) 1883.
- 15) L. Artus and Y. Bertrand, Solid State Commun. **61** (1987) 733.